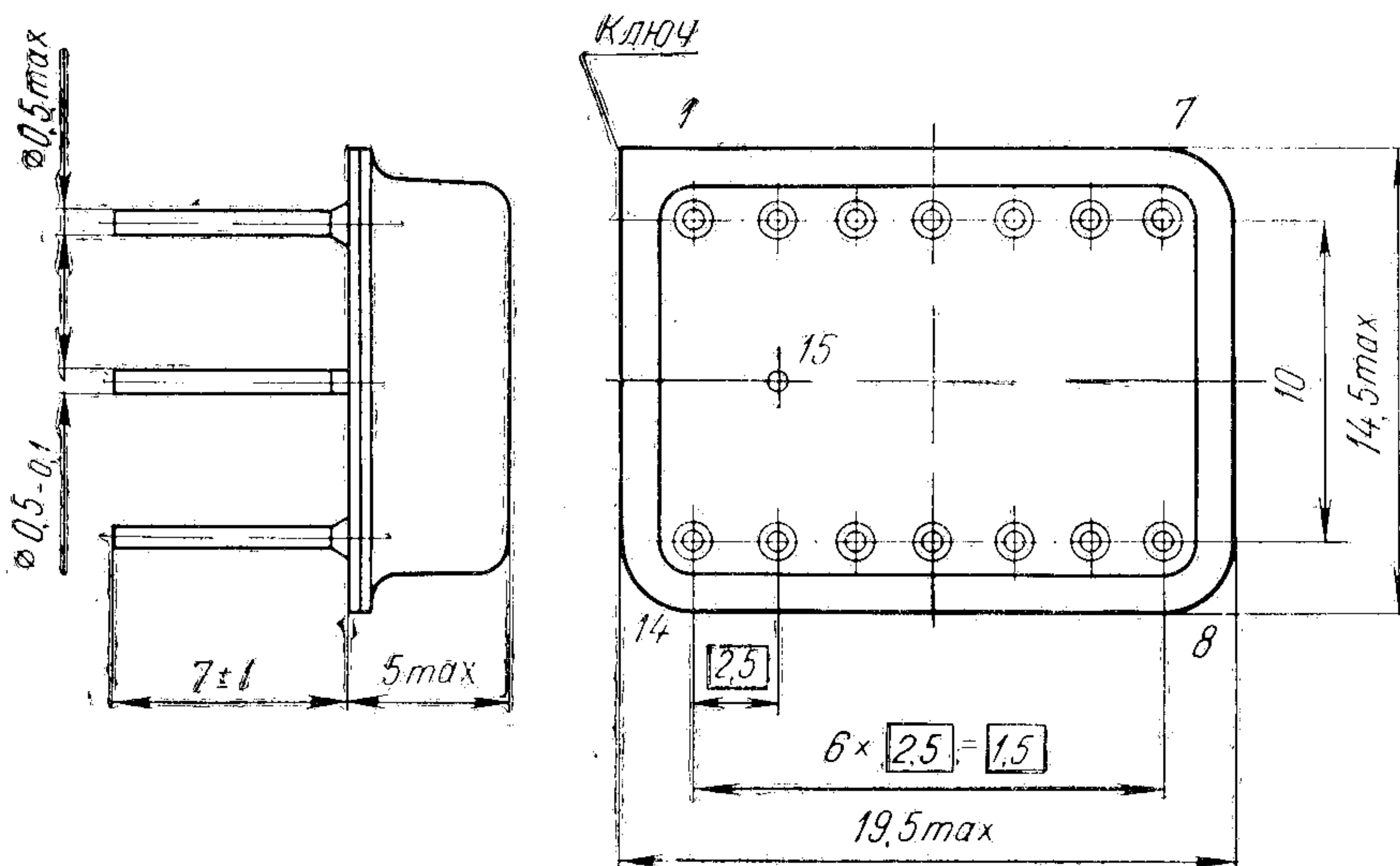


МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 401

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса не более 3 г

Нумерация выводов микросхемы указана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, $m \cdot c^{-2}$ (g)	400 (40)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, $m \cdot c^{-2}$ (g)	10 000 (100)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение, $m \cdot c^{-2}$ (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5

Линейное ускорение, $m \cdot c^{-2}$ (g)	5000 (500)
--	------------

Акустический шум:

диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	160

Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.).	665 (5)
---	---------

Атмосферное повышенное давление, атм	3
--	---

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 401

Общие данные

Повышенная температура среды, °С	85
Пониженная температура среды, °С	минус 60
Изменения температуры среды, °С	от минус 60 до +85
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка ^О , ч	25 000
Срок сохраняемости ^О , лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

При установке микросхемы в аппаратуру необходимо обеспечить (с помощью прокладки) надежный электрический контакт основания микросхемы по всему периметру с корпусом аппаратуры.

Должны быть приняты меры, исключающие передачу механических напряжений в месте спая стекла с металлом при монтаже, пайке, формовке и обрезке выводов микросхемы.

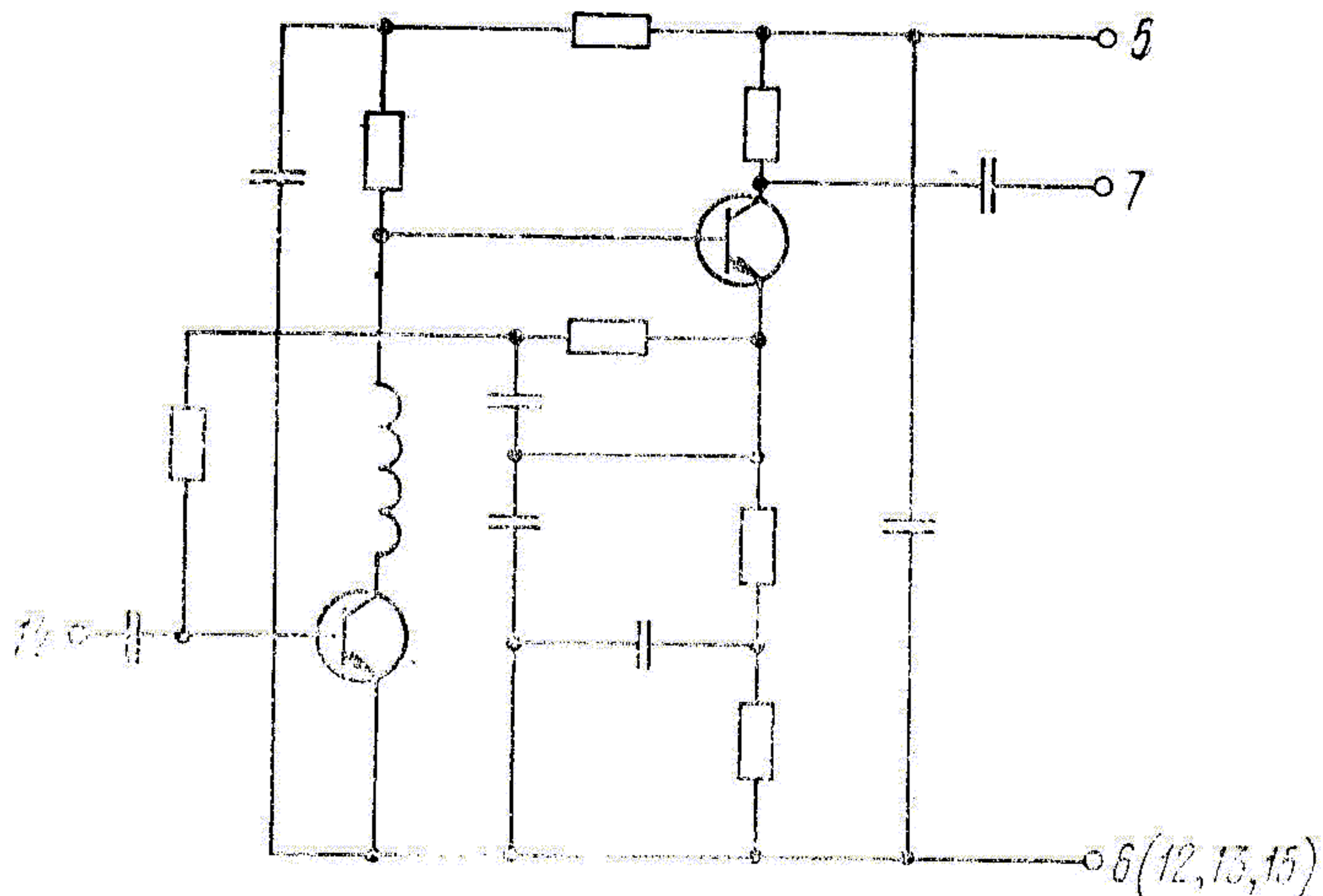
Прокладку рекомендуется изготавливать из бронзовой ленты Бр. КМц 3-1 ГОСТ 4748—70 толщиной 0,15—0,2 мм, поверхность которой должна быть рифленой и покрыта токопроводящим антикоррозийным покрытием. Прокладку необходимо по всему периметру припаять к корпусу аппаратуры (монтажу печатной платы). Рекомендуется применять механический прижим основания микросхемы к корпусу аппаратуры.

Допустимое значение статического потенциала 100 В.

Все виды оборудования и корпуса микросхем должны быть электрически заземлены. В случае, если нельзя использовать прямое заземление, необходимо применять электростатическое.

^О В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА



- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1—4 — свободные | 8—11 — свободные |
| 5 — +6 В | 12—13 — корпус (—6 В) |
| 6 — корпус (—6 В) | 14 — вход усилителя |
| 7 — выход усилителя | 15 — корпус (—6 В) |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$6 \pm 10\%$
Ток потребления, мА, не более	20
Коэффициент усиления мощности при $f=400$ МГц, дБ, не менее	15
Коэффициент неравномерности амплитудно-частотной характеристики при f от 60 до 600 МГц, дБ, не более	3
Коэффициент шума при $f=400$ МГц, дБ, не более	2,5
Амплитудное значение напряжения пульсаций, мВ, не более	200
Амплитудное значение переходных сигналов по цепям питания при $\tau_{н} \leq 1 \cdot 10^{-3}$ с, мВ, не более	600

401УВЗ

УСИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Напряжение питания, В:

максимальное 6,6

минимальное 5,4

Максимальная нижняя частота полосы задержива-
ния при $K_{у.р} \geq 12$ дБ, МГц 50

Минимальная верхняя частота полосы задержива-
ния при $K_{у.р} \geq 12$ дБ, МГц 900

Максимальная мощность входного сигнала, мВт 10